

沈阳芯源微电子设备股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为践行以“投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可以及切实履行社会责任，沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 18 日发布了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称《行动方案》）。公司根据《行动方案》内容，积极开展和落实各项工作，现将 2026 年上半年的主要工作成果报告如下：

一、聚焦经营主业，持续巩固和增强核心竞争力

自成立以来，公司始终专注于半导体专用设备的研发、生产和销售，产品包括光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备，广泛应用于国内各大晶圆厂、先进封装厂、化合物半导体等厂商。作为国内涂胶显影设备细分领域龙头企业，目前公司产品涵盖 offline、I-line、KrF、ArF 浸没式等多种工艺类型。

2026 年上半年，公司在前道涂胶显影、前道化学清洗、后道键合品类等多个业务板块持续进行研发投入，产品综合竞争力持续提升，2026 年上半年公司研发费用达到 1.38 亿元。报告期内，公司实现营业收入 8.97 亿元，同比增长 26.47%，营业收入保持增长；归属于上市公司股东的净利润 806.22 万元，同比降低 49.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.45 亿元，由于相比 2025 年同期人员成本增长、政府补助减少等原因，报告期内净利润有所下滑。截至报告期末，公司资产总额 63.72 亿元，较上年度末下降 1.08%，归属于上市公司股东的净资产 28.15 亿元，较上年度末增长 0.79%，公司资产规模基本稳定，资产质量良好。

2026 年上半年，公司前道涂胶显影机产品持续获得国内头部逻辑、存储、功率客户订单，客户认可度不断提升；公司战略性新产品前道化学清洗机签单表现优秀，高端 SPM 机台已通过国内头部客户工艺验证，获得国内客户高度认可，目前公司化学清洗机已获得国内多家大客户重复性订单；前道物理清洗机成功获

得国内头部客户批量订单，进一步夯实细分市场龙头地位；后道涂胶显影机及单片式湿法设备持续巩固国内领先优势，报告期内，继续获得封装龙头客户批量重复性订单；新产品临时键合机、解键合机、Frame 清洗机等已顺利通过多家客户验证，开始进入逐步放量阶段。

1、把握行业发展机遇，立足涂胶显影主赛道做优做强

根据 SEMI 预测，未来几年下游市场对电子产品的成长需求以及人工智能创新带来的应用浪潮将继续引领晶圆厂进行产能扩张，全球前道 300mm 晶圆厂设备支出预估将持续增长。根据 SEMI 2026 年 4 月发布的《300mm 晶圆厂展望报告》，预计 2026 年全球 300mm 晶圆厂设备支出将增长 18%，达到 1330 亿美元；2027 年预计将增长 14%，规模至 1510 亿美元；2028 年预计增长 3%，规模至 1550 亿美元；2029 年预计将增长 11%，规模至 1720 亿美元，整体来看半导体设备支出保持稳步增长态势。作为半导体产线上唯一与光刻机联机作业的核心工艺设备，国内前道涂胶显影机市场目前仍被国外厂商高度垄断，是少数几种国产化率仍维持在较低水平的“短板环节”。经过多年努力，公司目前已成功推出包括 offline、I-line、KrF、ArF 浸没式等在内的多种型号产品，成功在下游客户端抢占一席之地。

2026 年上半年，公司前道涂胶显影产品持续获得国内头部客户订单，offline、I-line、KrF 等机台在多家客户端量产跑片数据良好，客户认可度不断提升。

2、围绕下游客户需求，积极培育化学清洗等多个新业务增长点

集成电路前道晶圆加工领域，公司战略性新产品前道单片式化学清洗机具有高工艺覆盖性、高稳定性、高洁净度、高产能等多项核心优势，能够适配多种 SPM 工艺，整体工艺覆盖率达到 90%以上。公司高端 SPM 化学清洗机已成功通过多家客户工艺验证，获得国内客户高度认可，目前公司化学清洗机已获得国内多家大客户重复性订单。该机台的推出，标志着公司从前道物理清洗领域成功跨入到技术含量更高、市场空间更大的前道化学清洗领域，将公司前道产品（涂胶显影+清洗）的国内市场空间由原来的百亿元人民币大幅提升至两百亿元人民币，进一步完善了公司在前道领域的战略布局。2026 年上半年，公司进一步加大对化学清洗产品的客户端推广及验证力度，做好潜在客户签单及生产交付工作，同时继续加大研发投入，不断开发并覆盖其他工艺空白领域，持续优化和提升产品工

艺能力，为客户提供更先进、更具性价比的化学清洗产品。

集成电路后道先进封装领域，公司生产的涂胶显影设备、单片式湿法设备已连续多年作为主流机型批量应用于国内各主流先进封装厂，部分技术已达到国际领先水平，具有较强的全球竞争力。为积极响应国家支持 Chiplet 产业大发展的号召，公司基于在先进封装领域多年的技术积累和客户储备，积极围绕头部客户需求开展 2.5D/3D 先进封装相关产品的国产化替代，前瞻性研发临时键合、解键合设备，是国内较早进入该领域的设备厂商。2026 年上半年，该系列设备继续获得国内多家客户订单，顺利通过多家客户工艺验证并全面量产。此外，公司在 2.5D/3D 先进封装领域布局的新产品 Frame 清洗设备，也已成功通过客户验证，进入放量阶段。

3、加强自主创新力度，坚持高水平研发投入及成果转化

半导体设备属于高度技术密集型行业，具有极高的技术壁垒和客户准入门槛。多年以来，公司始终站在实现科技高水平自立自强的战略高度，将提高自主创新能力作为公司发展的第一要务，持续加大研发投入力度，研发费用连续多年保持在营业收入的 10%以上。

2026 年上半年，公司新增专利及软件著作权申请共计 32 项，新获专利及软件著作权授权 45 项，截至报告期末，公司共获得有效专利授权 436 项，其中发明专利 258 项，拥有软件著作权 139 项。此外，公司在内部也积极推行支持研发、尊重人才、提倡创新的浓厚氛围，鼓励研发团队持续跟踪市场发展动态及技术演进方向，不断提升现有产品竞争力水平，同时加速开展新产品开发及产业化。

二、优化运营管理，不断提升经营质量及效率

1、实施精益化、全过程管理，推动生产经营提质增效

2026 年上半年，公司持续推动信息化、数字化建设，落实精益化、全过程管理，以提高整体运营效率为目标，继续开展降本增效全员行动计划。公司将运营管理中的各项关键指标细化分解到各业务部门，包括新签订单、生产出货、合同验收、销售回款、费用管控等关键指标，同时在生产经营全过程设立一系列动态考核指标，覆盖质量、效率、库存、安全生产等多方面。公司指派专人持续动态跟踪各项指标的执行情况，定期反馈执行结果并提出改进要求。

2、强化全员质量管理要求，提升产品质量及机台交验及时性

2026 年上半年，公司继续将产品质量管控及机台交验及时性作为公司级运营目标，在质量管理方面推行信息化、标准化，将品质管理覆盖到产品生命周期的各个环节，从物料品质，到过程品质再到客户端品质，做到全流程可追溯、标准化管理。同时，公司针对关键岗位、关键工序制定了严格的绩效考核指标，确保产品生产及交付质量。

3、提高整体资金使用效率，保障运营资金需求及安全

公司所处半导体设备行业属于资金密集型行业，必须进行长期高强度的研发投入，尤其是公司所从事的光刻工序涂胶显影设备行业，因与光刻机高度绑定，机台机械结构及工艺复杂度较高，生产、安装调试及回款周期较长，资金占用量大，资金压力目前已成为阻碍公司健康稳定发展的重要问题，要实现提质增效，公司的资金保障能力尤为重要。

2026 年上半年，公司结合业务发展实际，继续通过优化库存管理、缩短产品交付及验收时间、加快回款进度等多种方式提高资金使用效率。同时，强化应收款项管理、加快产品交付与回款节奏，提升资金周转效率；深化银企合作，运用多元化融资工具，保障业务拓展资金需求。

4、优化供应链管理，持续推进核心物料国产化替代

半导体设备行业的供应链管理对于产品的质量保证及交付能力有着至关重要的影响。2026 年上半年，公司在供应链管理方面继续推动数字化、信息化、标准化建设，助力供应链高效、科学、规范管理。经过多年经营发展，公司目前已构建了面向全球的稳定可靠的原材料供应渠道，与数百家核心供应商建立了较为稳定的战略合作伙伴关系，对关键零部件采取多厂商策略及滚动预投，以确保关键零部件供应的及时性。此外，公司继续开展关键核心物料国产化替代工作，在保证品质的前提下，稳妥开展进口核心物料国产化替代（包括但不限于机械手、泵类、热盘、氟树脂部件等），力争全面实现进口核心物料自主可控。

三、重视提高股东回报，分享公司发展红利

公司高度重视股东的投资回报，努力为股东创造长期可持续的价值回报。公司积极实施现金分红并开展回购，增强投资者信心，推动公司股价同公司价值增长相匹配。

2026 年 8 月，公司实施了 2025 年年度权益分派，2025 年度权益分配方案以

实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元（含税），合计派发现金红利人民币 7,259,900.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

四、持续完善公司治理，提升规范性运作水平

1、完善内控建设，加强内部审计和风险控制

2026 年上半年，公司持续完善内控建设，结合公司实际情况，进一步提升公司的内部控制管理体系。公司完善风险预警和应对机制，定期开展内部审计和风险评估，确保公司稳健、合规运营。

2、深化公司治理，强化“关键少数”责任

2026 年上半年，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026 年 4 月修订）》《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等法律、法规、规章及规范性文件的最新要求，结合实际情况，公司完成对《公司章程》《利润分配管理制度》的修订，并制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

2026 年上半年，公司与董事、高级管理人员等“关键少数”人员保持紧密沟通。为强化“关键少数”的履职责任，持续发挥“关键少数”在公司规范运作中的重要作用，切实推动公司高质量发展。

3、加强董事会建设，安排董事及高管培训

公司积极组织公司董事及高管参与上交所、证监局等监管机构举办的相关培训，并安排董事及高管参加专业机构和公司内部专业人员的培训，推动公司董事及高管在尽职履责的同时，持续学习最新法律法规，重点掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，不断强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作。2026 年上半年，公司安排部分董事及高管参与了 2 次上述培训活动。

4、为独立董事创造良好的工作环境，强化其监督机制

2026 年上半年，公司为便于独立董事开展工作，指定证券投资部作为沟通

服务机构，专门负责会议议案材料编制、信息反馈等工作。公司及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，并提交相关文件，为独立董事开展工作提供便利，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督作用。

五、持续提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守信息披露相关规定，高质量开展信息披露工作，维护广大投资者的合法权益。一方面，公司加强信息披露全方位管控，构建较为完善的信息披露管理体系，保障经营管理的透明度和规范性；另一方面，公司坚持以投资者需求为导向，积极推进自愿性信息披露，重视披露内容的针对性、易读性、有效性，积极打造多渠道、多形式的投资者关系管理机制。

2026 年上半年，公司通过上市公司公告、公司官网及微信公众号、投资者交流会、业绩说明会、接待投资者现场调研、上证 e 互动、电话、邮件等多种渠道，将公司经营成果、财务状况等情况及时、公开、透明地传达给市场参与各方。报告期内，公司在上海证券交易所路演中心举办了 1 场业绩说明会，累计发布 2 份《投资者关系活动记录表》。同时，公司通过上证 e 互动平台回复了中小投资者提出的 11 条问题。公司通过以上举措多途径、全方位、及时传达公司的投资价值，在确保合规的前提下帮助投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展等信息，增强投资者对公司的信心和信任，吸引更多的投资者特别是中长期资金参与，努力夯实资本市场高质量发展基础。

六、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象

综上所述，2026 年上半年，公司严格执行此前制定的《行动方案》，并取得了一定进展。公司将持续评估《行动方案》的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，不断提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，与投资者共享经营发展成果，同时坚持以投资者需求为导向的信息披露，加强与投资者沟通交流，维护公司良好市场形象。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意相关风险。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日